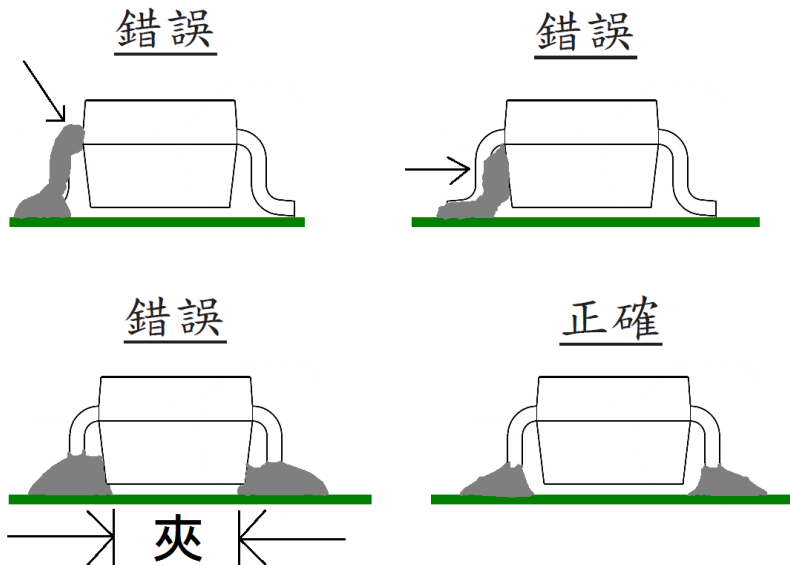


霍爾感應 IC 使用注意事項

《貼片式封裝》

- 焊接時，請盡量避免焊錫或錫膏等，沾黏至 pin 腳上段與黑色膠體交接處，以及避免沾黏在 pin 腳與黑色膠體之間。請避免錫量過多，使 IC 黑色膠體兩側被錫夾住。

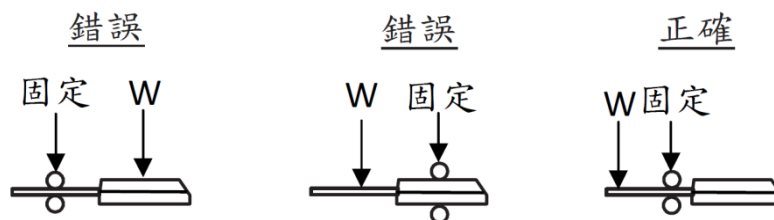


- IC 加工安裝後，若有用膠將其密封，請盡量使用柔軟有彈性的膠來包覆 IC，請避免使用會在變質過程中產生腐蝕性物質的膠。
- IC 加工過程中若使 pin 腳變形，易對 IC 造成應力，導致 IC 表現失常。
- IC 加工使用過程中，請盡量防止靜電流入。

《直插式封裝》

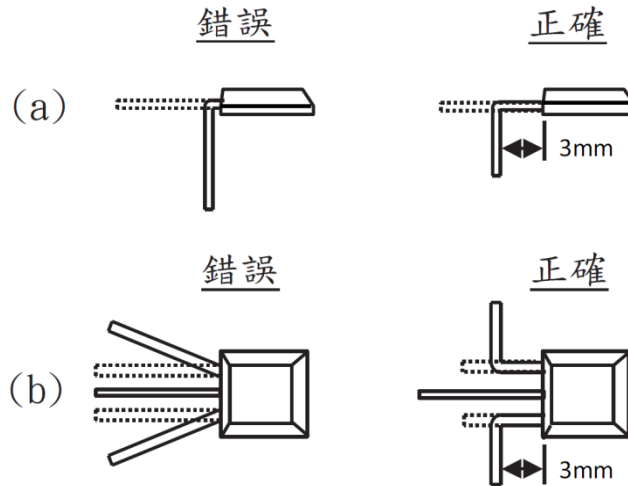
- IC 剪腳或折腳時，請盡量固定 pin 腳上段與黑色膠體交接處，以降低 pin 腳之形變力對 IC 造成的應力。碰觸 IC 黑色膠體時，請勿施加壓力，盡量避免壓住或夾住黑色膠體。

《固定方式》



Winson reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability.

《折腳方式》



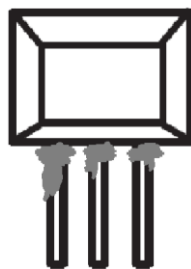
《剪腳位置》



※ 建議：pin 腳加工位置約在 3mm 左右，加工過程不重壓樹脂，並使用金屬模緊密固定 IC 腳。

- IC 焊接時，請盡量避免焊錫或錫膏等，沾黏至 pin 腳上段與黑色膠體交接處。

錯誤



- IC 安裝後若有用膠將其固定或密封，請盡量使用柔軟有彈性的膠來固定或包覆 IC，請避免使用會在變質過程中產生腐蝕性物質的膠。
- IC 安裝使用過程中，請盡量防止靜電流入。

Winson reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability.